



AI TECHNOLOGY INC
70 Washington Road
Princeton Jct., NJ 08550
(609) 799-9388 传真 (609) 799-9308
电子邮件: ait@aitechnology.com
网址: http://www.aitechnology.com

PRIMA-BOND
ME7156

典型特性*

电阻率 (150 °C/ 60 min)	>1x10 ¹⁴ ohm-cm
介电强度 (Volts/mil)	750
玻璃转化温度 (°C)	-25
载流能力	不适用
抗撕裂强度	1000 psi 6.9 N/mm ²
器件抗拉拔强度	2400 psi 16.6 N/mm ²
硬度 (类型)	80 (A)
固化后密度 (gm/cc)	2.3
热导率	12 Btu-in/hr-ft ² -°F 1.7 W/m-°C
线性热膨胀系数 (ppm/°C)	120
连续工作的最高温度 (°C)	150
平均粘度 (0.5 rpm, 24°C) (Brookfield DV-1, Spindle CP51)	144,000 cp

* 所述特性为典型值，不用于制定规范。建议用户以产品制造和最终产品的设计应用方式评估本产品。

无应力
热传导
可返工
环氧粘结胶
适用于:
基板和元件
可返工
不匹配的CTE时

产品说明:

ME7156是一种可返工、氧化铝填充、电绝缘和热传导环氧粘结胶。它具有出色的柔韧性，能够粘接高度不匹配的CTE材料（即氧化铝-铝、硅-铜）。由于这种材料具有较高的热导率，因而可用于粘接大面积的芯片和元件。

ME7156可以在80-100°C的温度下轻松返工。建议使用带有陶瓷点胶头的容积式点胶设备。

包装方式:

ME7156的包装可以是自动点胶用的针筒包装，也可以是罐装。粘度和触变系数均可根据您的具体需求进行定制。

使用步骤:

- (1) 打开点胶罐或点胶针管前，应将其置于环境温度下直至解冻。
- (2) 在干净的基板上点胶。
- (3) 在60°C下预烘30至60分钟，以达到最佳粘合效果。不是所有应用都需要预烘烤**
- (4) 按照推荐的固化条件进行固化。

固化条件:

温度	时间	压力
80°C	8小时	
100°C	4小时	
125°C	2小时	
150°C	1小时	

** 对于高温固化，温度高于125°C时和（或）粘合面积超过1cm×1cm时，建议在器件安装和固化之前，以不带器件的敞开方式，在60°C下将仅点好胶的基板预烘30分钟。

保存期限:

存储温度	保存期限
-40°C	1年
开罐后使用时长	72小时, 25°C时

本文所包含的信息均真实可信。任何在未经确定的条件/方法下的建议均超出我们的可控范围。所述特性为典型值，不用于制定规范。建议用户以产品制造和最终产品的设计应用方式评估本产品。A. I. Technology在任何情况下对因使用或处理本产品而导致的意外、间接或其他损害均不承担连带责任。

虽然AI Technology拥有其产品材料配方的全部专利权，但制造某些产品的具体用途可能涉及其他公司的专利权。